

南亞技術學院研究發展處實習就業輔導組

廠商求才登記表

公司名稱	碩邦科技股份有限公司	填表日期	111年02月16日
公司地址	新竹市東區力行五路3號	統一編號	16130009
負責人	吳非艱	員工人數	6000
連絡人	HR-吳小姐	連絡電話	03-5678788 分機22404
E-mail	JeanWu@chipbond.com.tw		
公司網址	http://www.chipbond.com.tw		
服務項目	LCD 驅動 IC 封裝測試、捲帶式封裝載板--光電/半導體業		
勞動權益	☒ 勞、健保 ☒ 勞退 休假制度_____ (凡屬勞動基準法規訂定之項目請填入此欄位)		
福利制度	※碩邦為達成「兼具成就感與幸福感」的生命共同體，105~111年連續7年優於法令給予19天的國定假日與紀念日休假※ 1.任職年度期滿年薪可達14個月(內含三節獎金) 2.依該年度公司規定發放員工激勵獎金及分紅。 3.職工福利委員會(三節禮金、生日禮卷、旅遊禮卷、教育禮卷、婚喪喜慶補助等。) 4.任職第1天即享有特別休假。 5.完整的職前及在職教育訓練制度。 6.提供外縣市員工舒適便利及設備完善的冷氣套房宿舍。 7.備有多樣選擇及補助50%的員工自助餐廳，夜班同仁宵夜餐補助100%。 8.同仁免費健康檢查。 9.公司內備有停車場、連鎖便利商店、健身房、休閒育樂中心、ATM 自動提款機。 10.免費員工本人團體保險(含壽險、意外險、傷害醫療金、住院醫療險、癌症險、健康險)。 11.特約廠商消費優惠。 12.年資期滿可參加員工持股信託 ※於薪資外，另外提撥6%勞退金給員工個人帳戶。	是否進用身心障礙人員	✓
公司簡介	碩邦科技為擁有「覆晶封裝技術」與「晶片尺寸封裝(CSP ; Chip Scale Package)」此二類先進技術之專業封裝廠商，不論是自行販賣或代工生產，在數量上佔世界舉足地位。對於封裝方式進入輕薄、短小的要求時，國內獨缺凸塊製作之產業，本公司乃投入凸塊之代工並延續後段封裝之服務。本公司為國內凸塊領域進展最快，業績屢創新高。 其產品線的規劃可完全滿足未來封裝的主流需求。本公司之產品產製技術，舉凡金凸塊及錫鉛凸塊封裝、捲帶式接合封裝及晶圓級封裝技術，皆係由本公司技術團隊自行研發而得，並以自		

有研發技術為基礎，輔以國際半導體大廠在產品認證過程之實務製程經驗，使得本公司具有領先同業量產凸塊產品之優勢，並可提供凸塊代工客戶 Total Solution 的解決方案。為了因應半導體封裝對多腳化、高效能、高電性傳輸與高散熱性之需求，除持續投入可觀研發經費金凸塊產品製程、無電鍍製程、COF 封裝技術及無鉛產品等領域外，為加速研發技術能力之提升，同時與國內工研院及學校等研究機構單位及國外各半導體大廠進行技術交流與合作，擴大現有產品線與製程技能，以擁有全方位之封裝技術解決能力。							
職務名稱	人數	主要資格條件	待遇	工作內容	工作地點	工作時間	備註
技術員	不拘	不拘	月薪 28,000元 ~51,000元 (看班制)	1.機台操作 2.顯微鏡操作 3.生產相關事務處理	竹科、 湖口工業區	作四休二(常態)或 作三休三(貨少)加班機會多；日班07:20~19:20 夜班19:20-07:20 (固定班制，不輪調)	公司擴廠徵才
設備工程師	1-2	理工科系 會三用電表尤佳	月薪 30,000元 ~70,000元	1.產線設備維修與保養 2.產線異常排除	竹科、 湖口工業區	作四休二或作三休三日班08:30-20:30 夜班20:30-08:30	公司擴廠徵才
承辦人：馬木蘭 老師 TEL: (03)436-1070 #2123、9628 E-mail:1888@ms.nanya.edu.tw							